【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-523495(P2005-523495A)
【公表日】平成17年8月4日(2005.8.4)
【年通号数】公開・登録公報2005-030
【出願番号】特願2003-584838(P2003-584838)
【国際特許分類】
Ｇ０５Ｂ　19/418　(2006.01)
Ｇ０６Ｆ　17/50　(2006.01)
Ｇ０６Ｆ　19/00　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０５Ｂ　19/418　Ｚ
Ｇ０６Ｆ　17/50　６１２Ｈ
Ｇ０６Ｆ　17/50　６３６Ｄ
Ｇ０６Ｆ　19/00　１１０

【手続補正書】
【提出日】平成17年8月12日(2005.8.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
材料を製造するためのプロセスを一連のセグメントに分割し、かつセグメント各々を一つ以上の層を有するように形成するセグメントデータを受信するステップであって、前記セグメントデータは、前記製造プロセス内で前記材料が通る経路に沿って、および前記プロセスの少なくとも１つの構成要素の表面に沿って、前記製造プロセスを分割する、セグメントデータを受信するステップと；
前記セグメントデータの関数として、該セグメント各々の層の寸法に関するプロセスパラメータの値を計算するステップと；を含む方法。
【請求項２】
コンピュータ読取り可能媒体が命令を含んでいて、
該命令は、プロセッサに対して：
製造プロセス内で材料が通る経路に沿って、および前記プロセスの少なくとも１つの構成要素の表面に沿って、製造プロセスの一連のセグメントを規定するユーザからのデータを受信するためのユーザインターフェイスを提供させ、ここでセグメントデータが前記セグメントのそれぞれに関して１層以上の層を規定することと；
前記セグメントの前記層の厚さに関するプロセスパラメータの値を計算させることと；を行なわせるようになっている、
コンピュータ読取り可能媒体。
【請求項３】
システムが：
製造プロセスを規定し、前記製造プロセスを１層以上の層を有する一連のセグメントに分割するセグメントデータであって、前記製造プロセス内で前記材料が通る経路に沿って、および前記プロセスの少なくとも１つの構成要素の表面に沿って、前記製造プロセスを分割するセグメントデータを受信するためのユーザインターフェイスと；

前記層の厚さに関するプロセスパラメータの値を計算するために、１次元モデルを呼び出すための計算エンジンと；
を含むシステム。